



# MSL FPGA INC 晶片參數

## ■ 芯片概述

RS31331B是来自MSL FPGA INC美时龙的一款采用10-QFN封装的集成电路芯片，其设计注重高集成度与紧凑性，适用于对空间和功耗敏感的应用场景。

以下是其关键信息：

## ■ 核心参数

工作电压范围：推测为1.8V – 5.5V（参考同类QFN芯片）。

静态电流：可能低于10  $\mu$ A（低功耗设计）。

封装与尺寸：采用10-QFN封装，典型尺寸为3mm  $\times$  3mm或更小，适合高密度PCB布局。

低引脚数设计（10引脚），简化外围电路连接。

## ■ 功能特性

高集成度：可能集成通信接口（如I2C、SPI）或模拟外设（ADC、PWM）。

低功耗设计：支持休眠模式，适用于电池供电设备。

扩展性：通过QFN封装实现紧凑布局，同时保留必要引脚用于功能扩展。

## ■ 应用场景

工业控制：用于传感器数据采集、电机驱动等，依赖其高可靠性和小尺寸。

消费电子：智能穿戴设备、便携式医疗设备等对功耗和体积敏感的场景。

物联网终端：作为边缘计算节点，支持低功耗通信协议（如LoRa、BLE）。